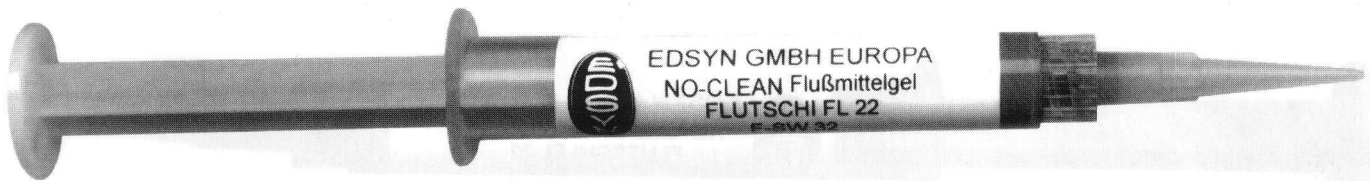


FL 22 FLUTSCHI Flußmittelgel / Flux Gel

Löten von SMT und Fine-Pitch-Bauteilen -
mit den EDSYN-MINI-FLOW-Lötspitzen und dem
Flußmittelgel FL 22 ein Kinderspiel

EDSYN MINI FLOW Tips and FL 22 flux gel - make soldering of
SMD and fine pitch components as easy as pie



Mit **FL 22 FLUTSCHI** Flußmittelgel wird über eine
eine konische Dosierspitze, Flußmittel gezielt und
sparsam auf SMD-Pads oder zu lötende Flächen
aufgetragen. Danach können herkömmliche Lötstel-
len leicht und einfach gelötet werden.

SMD-IC's nach dem Positionieren an den Beinchen
leicht mit Flußmittelgel benetzen. Danach wird mit
einem LONER SMD Lötgerät und der EDSYN - MINI
FLOW Lötspitze Lot an den Pads und Beinchen
aufgetragen. Kinderleicht gelingt das Anlöten von
schwierigsten Bauteilen.

Bei sorgfältiger Dosierung verbleiben kaum Rück-
stände auf der Leisterplatte, die in der Regel keine
Beeinflussung auf die Lötstelle haben.

In der Praxis hat sich gezeigt, daß aufgrund des
niedrigen Feststoffgehaltes auf das Waschen der mit
diesem Flußmittel gelöteten Leiterplatten, in der
Regel verzichtet werden kann.

Die Flußmittelzusammensetzung entspricht **FSW 32**
(DIN 29 454 / 1.1.3.A - DIN 8511).

Inhalt: 15 ml
Flußmitteltyp: DIN EN 29454 / 1.1.3. **F-SW 32**
Vorsicht:
* von Zündquellen fernzuhalten
* nicht rauchen
* Behälter dicht geschlossen
halten
* Zündpunkt: **420°C**

The conical proportioning tip of FL 22 FLUTSCHI
allows controlled and sparing application of flux to
SMD pads or any surfaces to be soldered. You can
then easily solder regular joints.

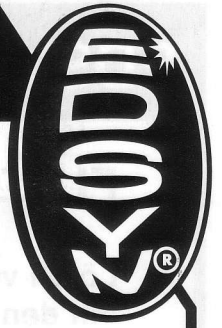
First, flux is sparingly applied to the legs of properly
positioned SMD ICs. Then solder is applied to pads
and legs using a LONER SMD soldering tool fitted
with an EDSY MINI FLOW tip. Now even the most
demanding soldering applications are no longer a
problem.

Flux residues, which hardly occur when **FL 22**
FLUTSCHI is carefully applied, usually do not affect
the soldering joint.

Practise has shown that using this flux with its low
solids content usually eliminates the need for was-
hing the soldered circuit board.

The composition of this flux complies with **FSW 32**
(DIN 29 454/1.1.3.A - DIN 8511)

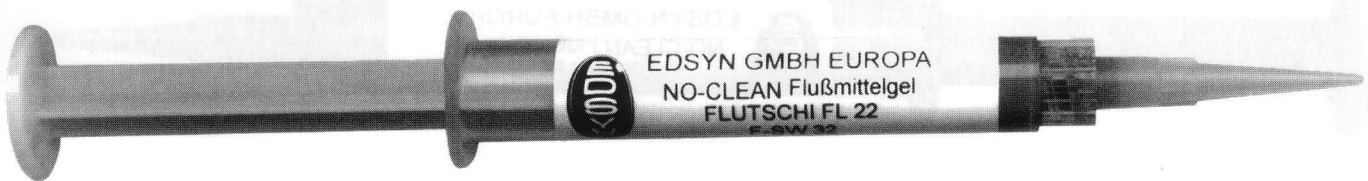
Content: 15 ml
Flux type: DIN EN 29454 /1.1.3. - F-SW 32
Precautions:
* keep away from ignition sources
* do not smoke
* keep container tightly closed
* ignition point 420 °C



FL 22 FLUTSCHI Flußmittelgel / Flux Gel

Löten von SMT und Fine-Pitch-Bauteilen -
mit den EDSYN-MINI-FLOW-Lötspitzen und dem
Flußmittelgel FL 22 ein Kinderspiel

EDSYN MINI FLOW Tips and FL 22 flux gel - make soldering of
SMD and fine pitch components as easy as pie



Vorteile:

- * **NO CLEAN - Flußmittel**
- * leichte Handhabung
- * leichte Dosierspritze
- * hervorragend geeignet für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen
- * einwandfreie Lötgergebnisse beim Einsatz mit Heißluft- und LötKolben, auch mit MINI FLOW Lötspitzen
- * schnelle Reparaturen werden möglich
- * Flußmittelgel kann sich nicht so schnell wie Flußmittel auf Alkoholbasis verflüchtigen
- * Aktivierung von verschmutzten Pads und Bauteilbeinchen

Advantages:

- * **NO CLEAN - flux**
- * easy handling
- * light weight proportion syringe
- * ideal for fine pitch and SMD applications
- * perfect soldering results with hot air tools and soldering irons; excellently suited for MINI FLOW soldering tips
- * enables quick repair
- * lower volatility than alcohol-based fluxes
- * activation of dirty pads and component legs